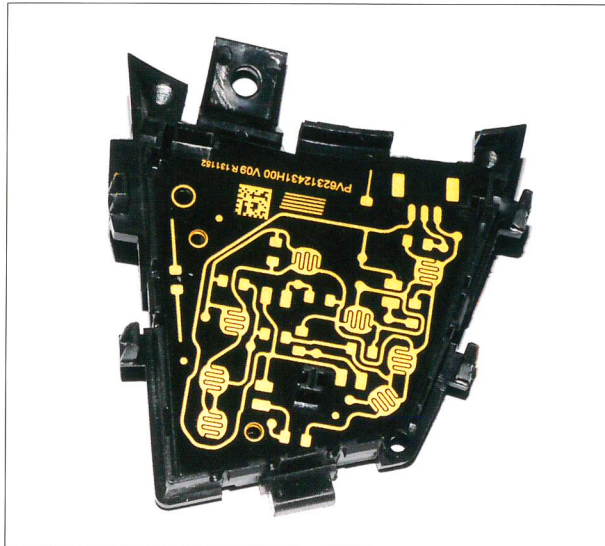




3D-MID Technologie



BMW Lenkradkomponente

Anwendungen

- > Automobilindustrie
- > Automatisierungstechnik
- > Medizintechnik
- > IT-Technik
- > Telekommunikation

Galvamedal ist gerne bereit, Sie mit diesem innovativen Verfahren bei Ihrer Problemlösung zu unterstützen. Wir stehen gerne für eine Bemusterung zur Verfügung.

Additiver Leiterbildaufbau für 3D-MID Teile mit Hilfe der Laserdirektstrukturierung (LDS) als Ersatz von Leiterplatten

Unter *MID (Molded Interconnect Devices)* versteht man spritzgegossene Kunststoffträger auf denen metallische Leiterbilder aufgetragen werden.

Durch die Kombination von mechanischen und elektrischen Funktionen kann das Gewicht und die Abmessungen des Bauteils deutlich reduziert werden.

Die Platzeinsparung, die 3D-Geometriefreiheit sowie die Reduktion der Anzahl der Komponenten ermöglichen eine grosse Designfreiheit und eine erhöhte Zuverlässigkeit.

Der Vorteil der Laserdirektstrukturierung liegt zudem in der Flexibilität des Verfahrens. Änderungen der Schaltungsdesigns können ohne Werkzeuge oder Masken vorgenommen werden, da das Schaltungsdesign direkt vom Computer (CAD-Daten) über den Laserstrahl auf den Kunststoffträger übertragen wird. Somit ist eine schnelle Designänderung gewährleistet.

Eigenschaften

Grundmaterial	LPKF LDS®-geeignetes LCP, PA, PBT
Beschichtung	Cu / Ni / Au
minimale Leiterbahnbreite	150 µm
Mögliche Montagetechniken (abhängig vom Grundmaterial)	SMD-Bestückung, Bonden
Design-Flexibilität	hoch
Leiterbild-Definition	Additiv